

08.04.22**Beschluss**
des Bundesrates

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz)
COM(2022) 46 final; Ratsdok. 6170/22

Der Bundesrat hat in seiner 1019. Sitzung am 8. April 2022 gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

1. Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich, dass die Kommission Maßnahmen ergreift, um die Resilienz des europäischen Halbleiter-Ökosystems insgesamt zu stärken und bis zum Jahr 2030 seinen Marktanteil auf mindestens 20 Prozent der weltweiten Produktion von fortschrittlichen und nachhaltigen Halbleitern zu erhöhen.
2. Er begrüßt die Zielsetzung, durch das Chip-Gesetz einen kohärenten Rahmen für die Stärkung des Halbleiter-Ökosystems der Union zu schaffen. Er kritisiert jedoch, dass der Fokus des Ökosystems ausschließlich auf dem Halbleiter-System im engeren Sinne liegt und nicht auch die Anwenderunternehmen umfasst. Nur durch eine Berücksichtigung der Bedarfe und Entwicklungen im Anwenderbereich kann sich das angestrebte Ökosystem Halbleiter effizient positionieren.
3. Aus Sicht des Bundesrates ist die Berechnung des finanziellen Gesamtvolumens des vorgeschlagenen Chip-Gesetzes bisher nicht hinreichend nachvollziehbar. Nach den derzeitigen Plänen sollen zudem nur relativ wenig eigene Mittel der EU in das Vorhaben fließen. Er fordert daher mehr Transparenz bei der Finanzierung und einen substantielleren Finanzierungsbeitrag durch die EU.

4. Der Bundesrat stellt fest, dass die beiden IPCEI Mikroelektronik zwar in der Begründung des Verordnungsvorschlags als Initiativen von strategischer Bedeutung für den Sektor Erwähnung finden, im Verordnungstext selbst jedoch nicht weiter behandelt werden. Es handelt sich hierbei jedoch um ein zentrales Instrument zur Unterstützung der Halbleiter-Initiative der Kommission, das aktiv eingebunden und mit Blick auf die Notifizierung auf EU-Ebene beschleunigt werden sollte. Das Instrument des IPCEI Mikroelektronik sollte daher aktiv im Rahmen des Chip-Gesetzes aufgegriffen werden.
5. Der Bundesrat weist darauf hin, dass gerade mittleren und großen Technologieknotten für deutsche und europäische Anwenderindustrien in Bereichen wie dem Automobilsektor, dem Maschinenbau, der Medizintechnik und den erneuerbaren Energien mittel- und langfristig große Bedeutung zukommt. Er hält es daher für notwendig, dass neue Investitionsfördermaßnahmen nicht ausschließlich auf kleinste High-End-Technologieknotten im Rahmen von Großansiedlungen konzentriert, sondern auch mittlere und große Strukturen einbezogen werden. Zu diesem Zweck sollte der im Verordnungsvorschlag vorgesehene Begriff der „neuartigen Anlage“ möglichst weit interpretiert werden. Ergänzend sollte geprüft werden, ob andere Instrumente in das Chip-Gesetz aufgenommen werden können, um dringend benötigte Kapazitätserweiterungen für die Produktion mittlerer und großer Knotengrößen zu fördern. Für diese Technologieknotten (unter anderem für Leistungshalbleiter und Sensorik) ist die Entwicklungs- und Produktionskompetenz bereits an europäischen Standorten vorhanden und sollte weiter gestärkt werden.
6. Aus Sicht des Bundesrates sollte klargestellt werden, dass das in Artikel 18 und den fortfolgenden geregelten Notfallinstrumentarium nur als Ultima Ratio in schwersten Krisen zum Einsatz kommen darf. Die stark international ausgerichtete deutsche Wirtschaft ist auf ein möglichst uneingeschränktes Handelsregime im globalen Halbleitermarkt angewiesen; eine Einschränkung des freien Handelsverkehrs darf nur in gut begründeten, WTO-konformen Ausnahmefällen in Betracht kommen.
7. Er sieht angesichts des zunehmenden Einsatzes und Bedarfs von individuellen, anwenderoptimierten Chips noch Klärungsbedarf, wie die in Artikel 22 geregelte zentrale Beschaffung als Teil des Krisenreaktionsmechanismus möglichst effektiv erfolgen kann.

8. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die vorgenannten Anliegen zu berücksichtigen und bei den weiteren Verhandlungen auf EU-Ebene einzubringen.